

股票代码：688403

股票简称：汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
（向不特定对象发行可转换公司债券 2024
年 8 月 6 日网上路演）

编号：2024-005

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与人员及单 位名称	参加公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的所有投资者
活动时间	2024年8月6日 15:00~17:00
活动地点	全景网（网址： https://rs.p5w.net ）
参与路演的发 行人及保荐人 嘉宾	汇成股份董事长、总经理 郑瑞俊 汇成股份副总经理 林文浩 汇成股份董事会秘书 奚颢 汇成股份财务总监 闫柳 海通证券投资银行委员会董事总经理 吴俊 海通证券投资银行委员会副总裁 赵庆辰
投资者关系活 动主要内容 介绍	路演开始后简要介绍了汇成股份可转债发行的基本情况，汇成股份董事长、总经理郑瑞俊先生以及海通证券投资银行委员会董事总经理吴俊先生等六位路演嘉宾分别致辞，并回答了投资者提出的如下主要问题，完整问答记录详见全景网（网址： https://rs.p5w.net ）。

1、问：针对这次可转债募投项目，公司有哪些产能消化措施？

答：尊敬的投资者您好！针对本次募投项目，公司已制定一系列措施用于消化新增产能，主要包括：（1）持续加大研发投入，提升公司产品的各项标准以满足客户及终端产品需求；（2）持续跟踪服务现有客户，深度绑定行业内主要晶圆设计厂商及代工厂商，强化与其合作深度；（3）持续增强营销服务队伍，完善考核激励制度。谢谢！

2、问：公司本次可转债的转股价是多少？怎么确定的？什么时候能转股？

答：尊敬的投资者您好！本次发行的可转债的初始转股价格为 7.70 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2024 年 8 月 13 日（T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。谢谢！

3、问：请问本次发行的债券有没有担保？

答：尊敬的投资者您好！本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在的兑付风险。谢谢！

4、问：本次可转债发行完成后什么时间安排上市？

答：尊敬的投资者您好！本次发行结束后，发行人将尽快办理有关上市手续，申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间将另行公告。谢谢！

5、问：公司在人才壁垒方面提到，集成电路行业对专业人

才需求大，但人才短缺。公司如何解决这一问题，以确保人力资源的可持续发展?是否有特定的人才培养和发展策略?

答：尊敬的投资者您好！公司高度重视人才的管理，上市后已实施限制性股票激励计划对公司关键人才进行激励，公司未来也将进一步加大产品技术方面的人才引进，改善队伍人才结构，确保公司人才的竞争力。谢谢！

6、问：公司发可转债是不是看好 OLED 显示驱动芯片市场，想问下 OLED 显示驱动芯片这几年的出货量大概是什么情况？

答：尊敬的投资者您好！根据 Frost & Sullivan 的数据和预测，中国大陆 OLED 显示驱动芯片出货量从 2016 年的 0.80 亿颗增至 2020 年的 2.70 亿颗，年复合增长率为 35.54%，预计 2025 年中国大陆 OLED 显示驱动芯片产量将增至 7.80 亿颗。谢谢！

7、问：面对全球显示驱动芯片市场的快速变化，尤其是中国大陆市场份额的提升，公司有哪些具体的市场拓展策略？如何抓住本土市场增长的机遇，进一步提升市场份额？

答：尊敬的投资者您好！公司主要客户均为全球知名的显示驱动芯片设计公司，同时顺应显示驱动芯片产业链整体向中国大陆转移的趋势，公司持续加强与集创北方、天德钰、新相微、爱协生、云英谷等中国大陆客户的深度合作，有助于巩固公司的市场份额及行业地位。谢谢！

8、问：面对国际贸易环境的不确定性，尤其是考虑到部分高阶设备依赖进口，公司如何保障供应链的稳定性和设备供应的及时性?在未来的项目规划中，是否会考虑增加国产设备的比例以降低对外部环境的敏感性？

答：尊敬的投资者您好！公司已逐步对机器设备进行国产化替代，与国内优质厂商展开合作，公司目前金凸块制程当中溅射、光刻、电镀等工艺环节相当一部分机器由国产半导体设备厂商供应。谢谢！

9、问：您好，请问如果参加了优先配售之后，还能再参加网上申购吗？

答：尊敬的投资者您好，原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。谢谢！

10、问：您好，在合肥新汇成微电子股份有限公司的本次募投项目中，预计新增收入高达 45,142.44 万元，这将对公司未来营收产生显著影响。请问这些新增收入的主要来源是什么产品或服务？这些产品或服务在市场上的竞争优势体现在哪些方面呢？

答：尊敬的投资者您好！公司本次募投项目预计新增收入将主要来源于 OLED 等新型显示驱动芯片封装测试服务。随着消费升级和技术进步，消费电子产品呈现更薄、更轻的发展趋势，消费者也更加青睐于具有轻薄设计的电子产品。由于 OLED 显示屏具有更加轻薄的属性，其应用范围逐步拓展。近年来 OLED 显示屏市场需求快速增长，市场渗透率快速提升，已成为显示驱动芯片行业重要的发展趋势。谢谢！

11、问：作为投资者，我们非常关心知识产权的保护。公司在保护这些专利技术方面采取了哪些措施，以防止技术泄露和保障公司的知识产权不受侵犯？

答：尊敬的投资者您好！公司为保障核心技术的权属完整与清晰，对技术成果的分配都做出了相应的权属分配条款规定，对于通过内部审查的技术发明，会以公司为主体向国家知识产权局申请注册专利，以保护知识产权；为防范核心技术泄露，公司建立了核心技术保密制度，与主要技术人员均签订了保密协议和竞业禁止协议，约定了技术成果归属、保密义务、竞业限制义务等。谢谢！

12、问：在应对本次发行摊薄即期回报的措施中，公司有何具体的策略来保障中小投资者的利益？这些措施的执行力度

和预期效果如何呢？

答：尊敬的投资者您好！公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力，具体措施如下：1、严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用；2、稳步推进募集资金投资项目建设，争取尽快实现效益；3、完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障；4、完善利润分配政策，重视投资者回报。谢谢！

13、问：公司在 12 吋先进制程新型显示驱动芯片的晶圆测试与封装领域有着怎样的竞争优势？面对国际大厂的竞争，公司如何确保技术的领先地位并持续吸引客户？

答：尊敬的投资者您好！公司在 12 吋显示驱动芯片封测领域拥有领先的技术研发优势、知名客户的资源优势、专业的管理团队优势、全流程统包生产优势、地理与产业集群优势。公司拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。公司将根据行业发展的趋势和下游客户的需求，围绕现有产品和技术成果，在现有产品结构优化、工艺优化以及新产品开发等方面不断创新，巩固公司行业的领先地位。谢谢！

14、问：公司通过员工持股平台和限制性股票方式进行股权激励，这些激励措施是否会摊薄现有股东权益？如何平衡激励效果与股东利益？

答：尊敬的投资者您好！公司通过员工持股平台和限制性股票方式进行股权激励，可以充分调动员工的积极性和创造性，建立健全公司长效激励机制，有利于稳定重要员工和持续改善公司的经营状况，为股东创造更多的价值。谢谢！

15、问：公司可转债存在限售期吗？大股东和董监高如果

	<p>买了的话什么时候可以减持？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！本次发行的汇成转债不设持有期限限制，投资者获得配售的汇成转债上市首日即可交易。持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员交易公司可转债需要遵守《证券法》关于短线交易的相关规定。谢谢！</p> <p>16、问：公司这次可转债的募投项目不构成新业务吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！本次可转债的募投项目均围绕现有主营业务展开，公司目前已具备 OLED 显示驱动芯片封测能力，本次募投项目结合当前 OLED 等新型显示驱动芯片市场需求和技术发展趋势，通过购置先进的设备和软件，开展新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造、晶圆测试服务，扩充公司 OLED 显示驱动芯片封测产能，不构成新业务。谢谢！</p> <p>17、问：公司这次可转债募投项目计划要买的设备是国产为主还是进口为主？公司主要设备国产化情况怎么样？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司本次募集资金所购置的设备以进口为主。公司目前金凸块制程中溅射、光刻、电镀等工艺环节主要设备系向国产设备厂商采购，晶圆测试等后道制程中所需高端测试机、切割机、ILB 等设备目前以进口为主。谢谢！</p> <p>18、问：在新增大量固定资产带来的折旧摊销压力下，公司将如何优化运营效率，提升盈利能力，以抵消这一影响并保持良好的盈利水平？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司本次募投项目主要投向 OLED 等新型显示驱动芯片封测领域，近年来 OLED 显示屏市场渗透率快速提升，显示驱动芯片作为 OLED 屏的上游产业，晶圆封装和测试服务的需求量也会大幅上涨，公司将稳步推进募集资金投资项目建设，争取尽快实现效益，提升公司盈利能力。谢谢！</p>
<p>是否涉及应披露重大信息的</p>	<p>不涉及</p>

说明	
附件清单（如有）	无
上传日期	2024年8月7日